

Innovation für das Nutzentrennen



Im Full Cut-Verfahren (trennen ohne Stege) können mit den neuen Lasernutzentrennern der Dividos-Serie bis zu 30 % mehr Nutzen auf einer Leiterplatte vorgesehen und getrennt werden. Die Neuentwicklung der InnoLas Solutions GmbH, einem Unternehmen der Photonics Systems Group, erfüllt alle Anforderungen an das Lasernutzentrennen von starren und flexiblen Leiterplatten und trennt unterschiedliche Materialien extrem schnell, stressfrei und ohne Rückstände. Durch den Einsatz eines zweiten Galvanometer Scanners wird der Durchsatz verdoppelt.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 2,34 €

2,50 €

Netto-Preis: 2,34 €

Enthaltene MwSt.: 0,16 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)